

SPECIFICHE TECNICHE

CIG: ZA3259B847

"Sistema di ispezione ottica adibita al montaggio e e rework di schede elettroniche"

Il sistema, prima di tuttodeve consentirela possibilità di visualizzare su monitor, e salvare le immagini ma soprattutto di lavorare manualmente (rework o montaggio componenti smd) su schede elettroniche, quindi con uso di saldatore/dissaldatore a stagno.

Quindi deve avere le seguenti caratteristiche minimali

- -Distanza minima focale 180mm con ingrandimento min.22,5X
- -Illuminatore a led con variatore di intensità,min. 4000k
- -Telecamera con risoluzione 5MP e software interno di acquisizione immagini
- -Basedi supporto con braccio ergonomico, in acciaio,registrabile sia in altezza che in inclinazione
- -Monitor a colori min. 24" completo di cavo HDMI
- -Range di ingrandimenti min da 8,8x - 91x ottico (178x digitale)
- Può anche disporre di microscopio stereozoom

Il Responsabile del Procedimento

Sauro Bizzaglia

Sauro Bizzaglia